

附件 2

科研项目关联业务专家评审意见表

业务名称	SiC衬底采购			
业务主要内容	6寸SiC导电衬底采购			
采购人	宋华平	采购方式	三方报价	
评审时间	2019.12.20	评审地点	A1-221	
参加供应商名单:				
序号	名称	本项目单价	本项目报价	备注(是否关联方)
1	北京天科合达半导体股份有限公司	Z级: 9000元/片 P级: 4800元/片	474000元	是
2	Cree (美国)	Product U Grade: 11800元/片 Product V Grade: 9800元/片	639000元	否
3	DuPont (美国)	Prime Select Grade: 16931元/片 Prime Standard Grade: 13174元/片	912420元	否
关联业务必要性、合理性分析		北京天科合达半导体股份有限公司是国内SiC导电型衬底的龙头企业, 而国内其它SiC衬底厂尚不具备商业提供6寸SiC导电衬底的能力。天科合达提供的6寸SiC导电衬底相对国外公司具有价格优势。		
单一来源特殊采购形式论证		单一来源采购原因	是否有排他性条款说明	
拟推荐供应商		名称	是否关联方	拟成交价格
		北京天科合达半导体股份有限公司	是	474000元
推荐理由:		在合格供应商中, 天科合达具有明显性价比优势。		
专家组成员名单	姓名	工作单位(部门)名称	职称/职务	签名
	郑华	东莞理工学院电子工程与智能化学院	副教授/副处长	郑华
	高博	深圳第三代半导体研究院战略及研发部	高级工程师	高博
	曹永革	松山湖材料实验室透明陶瓷团队	教授	曹永革
	张安平	松山湖材料实验室SiC半导体器件团队	教授	张安平
	陈熙基	松山湖材料实验室创新样板工厂发展部	部长	陈熙基
归口部门意见		科研部	部长	王立文
备注: 本表原件留相关主管部门存档并在材料实验室内公示, 复印件随借款/报销单到财务办理付款手续。 (如因表格栏目、字数所限填写不下, 可另附详细论证意见和评审报告)				